

2021年11月10日

NEDIA 会員各位

(一社)日本電子デバイス産業協会  
材料部品部会部会長 佐藤中則

**材料部品部会主催・第三十三回勉強会開催のご案内**

晩秋の候、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

早速ですが下記の日程で「第三十三回材料部品部会主催の勉強会」を開催いたします。

今回の講演では、セミコンサルトの上田様には”車載半導体パッケージの技術動向“について、また(株)産業タイムズ社の泉谷様には“ニッポン半導体復活のカギ“について、それぞれお話をさせていただきます。

新型コロナウイルス感染防止に努めながらの開催になりますが、是非大勢の方のご参加をお待ちしております。

—記—

1. 日時 2021年12月2日(木) 14:00~16:40
2. 場所 喜山倶楽部 飛鳥の間  
東京都千代田区一ツ橋 2-6-2 日本教育会館 9F tel 03-3262-7661  
<https://kizan-club.com/access>
3. 講演スケジュール  
14:00~14:50 「自動運転に向けたセンサ三種の神器と、  
車載用半導体パッケージの技術動向について」  
セミコンサルト 代表 上田 弘孝 氏  
14:50~15:00 休憩  
15:00~16:40 「ニッポン半導体復活のカギは、国家の総力をあげる体制にあり！  
～装置、材料の強さを生かしてメモリー、ASICで画期的開発推進」  
(株)産業タイムズ社 代表取締役会長 泉谷 渉 氏

- ・参加希望の方は、11月25日(木)までに以下の申込フォーマットにて事務局宛に返信をお願い致します。
- ・当日会場にて資料代として NEDIA 会員の方は 2,000 円/人、非会員の方は、5,000 円(資料代を含む)を徴収させていただきます。

以上

-----材料部品部会第三十三回勉強会参加申込-----

会社・団体名：

部署・ご役職：

氏名：

連絡先：

会員確認： NEDIA 会員 ・ 非会員 (該当するものを残してください)